

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011 年 4 月 28 日(28.04.2011)



(10) 国際公開番号
WO 2011/049011 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 163/02 (2006.01) *C09J 11/00* (2006.01)
C09J 4/02 (2006.01) *C09J 179/08* (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01) *H01L 21/52* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/068133
- (22) 国際出願日: 2010 年 10 月 15 日(15.10.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-240162 2009 年 10 月 19 日(19.10.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 嶋田彰 (SHIMADA, Akira) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 立花康子 (TACHIBANA, Yasuko) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 仁王宏之 (NIWA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 野中敏央 (NONAKA,

Toshihisa) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

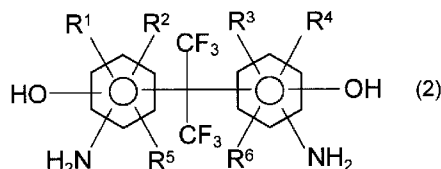
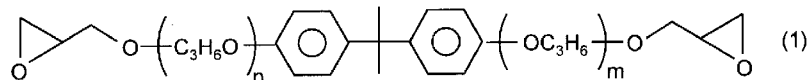
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: PHOTSENSITIVE ADHESIVE COMPOSITION, PHOTSENSITIVE ADHESIVE SHEET, AND SEMICONDUCTOR DEVICES USING SAME

(54) 発明の名称: 感光性接着剤組成物、感光性接着剤シートおよびこれらを用いた半導体装置



(57) Abstract: A photosensitive adhesive composition which comprises (A) an epoxy compound, (B) a soluble polyimide that contains residues of a diamine represented by general formula (2), (C) a photopolymerizable compound, and (D) a photopolymerization initiator, wherein the epoxy compound (A) contains an epoxy compound represented by general formula (1) and the soluble polyimide (B) contains residues of a diamine represented by general formula (2). In general formula (1), m and n are integers of 0 or larger that satisfy the relationship: $1 \leq m+n \leq 10$; and x is an integer of 1 to 5, and y is an integer of 1 to 10, with x and y satisfying the relationship: $y = 2x$. In general formula (2), R^1 to R^8 may be the same or different from each other and are each selected from the group consisting of hydrogen atom, C_{1-30} alkyl, C_{1-30} alkoxy, halogen, sulfone group, nitro, and cyano. The photosensitive adhesive composition can be developed after light exposure by means of an alkali developer, exhibits high bond strength when applied to a substrate by thermocompression, and ensures excellent insulation reliability.

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2011/049011 A1